

## 財團法人台灣建築中心 函

地址：231新北市新店區民權路95號3樓  
承辦人：楊明睿  
電話：02-8667-6111#210  
傳真：02-8667-6222  
電子信箱：wool57632@tabc.org.tw

受文者：社團法人新竹市建築師公會

發文日期：中華民國113年1月31日

發文字號：中建學字第1139060012號

速別：普通件

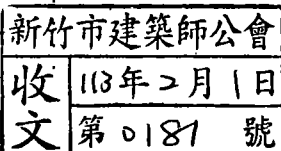
密等及解密條件或保密期限：

附件：推動「科學園區淨零建築發展」說明會-議程 (9060012A00\_ATTCH4.pdf、9060012A00\_ATTCH3.jpg)

主旨：關於財團法人台灣建築中心主辦「推動『科學園區淨零建築發展』說明會」1案，詳如說明，惠請貴機關淨零建築專責人員、企業資產開發人員、設計師及財務規劃人員、並轉知機構會員團體相關人員踴躍參加，請查照。

說明：

- 一、說明會將針對「內政部淨零發展政策」，以科學園區企業ESG深遠發展，基於自身興辦廠房或辦公建築開發之法令範疇、既有辦公建築之能效評估BERS盤查提供說明與諮詢，邀請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提供園區企業在綠色債券籌措內容及方式說明，及本中心提供建築能效申請認定範疇及審查資料並能接軌綠色融資實施說明，俾利產業協力輔導企業資產用戶，鼓勵企業在積極投入永續時，由興辦設計至營運皆可納入建築能效評估，不論是企業總部辦公大樓或單一空間物業資產或租賃辦公室空間的使用人，皆可透過既有建築能效評估取得評鑑等級；在園區辦公場域都應該是淨零建築接軌國際的原則下（



<https://reurl.cc/VNY00A>)，進一步落實企業永續報告書的量化揭露，思考如何透過綠色財務融資及面對不動產證券基金化新制度，展開履行資產ESG的承諾。

二、本次說明會訂於113年2月27日(星期二)13:30至16:30，假台灣科學園區科學工業同業公會203會議室舉行，地址：新竹科學園區展業一路2號。

三、檢附旨案活動摘要與報名方式(如附件)，請於113年2月23日前報名網址：<https://reurl.cc/WRGgLD> 先行報名，正式會議前3-5日會發送確認通知信，倘有相關疑義，請洽詢財團法人台灣建築中心(電話02-86676111)聯絡人員：楊先生分機210、wool57632@tabc.org.tw。

正本：新竹市政府產業發展處、新竹市政府都市發展處、新竹市政府環境保護局、新竹縣政府工務處、新竹縣政府環境保護局、新竹縣政府產業發展處、新竹市政府工務處、社團法人新竹市建築師公會、社團法人新竹縣建築師公會、新竹市不動產開發商業同業公會、新竹縣不動產開發商業同業公會、新竹市室內設計裝修商業同業公會、新竹縣室內設計裝修商業同業公會、台灣科學園區科學工業同業公會、新竹市冷凍空調業職業工會、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局、社團法人中華民國企業永續發展協會、台灣積體電路製造股份有限公司、聯華電子股份有限公司、友達光電股份有限公司、力晶積成電子製造股份有限公司、光寶科技股份有限公司、旺宏電子股份有限公司、聯合再生能源股份有限公司、京元電子股份有限公司、元太科技工業股份有限公司、力成科技股份有限公司、南茂科技股份有限公司、神基科技股份有限公司、中美矽晶製品股份有限公司、合晶科技股份有限公司、瑞昱半導體股份有限公司、合勤科技股份有限公司、致茂電子股份有限公司、啟碁科技股份有限公司、台亞半導體股份有限公司、晶豪科技股份有限公司、台揚科技股份有限公司、敦泰電子股份有限公司、天鈺科技股份有限公司、希華晶體科技股份有限公司、原相科技股份有限公司、揚明光學股份有限公司、聯合骨科器材股份有限公司、聯傑國際股份有限公司、力旺電子股份有限公司、閎康科技股份有限公司、群創光電股份有限公司、矽品精密工業股份有限公司、緯創資通股份有限公司、佳世達科技股份有限公司、世界先進積體電路股份有限公司、聯發科技股份有限公司、神達電腦股份有限公司、晶元光電股份有限公司、碩邦科技股份有限公司、聯詠科技股份有限公司、凌陽科技股份有限公司、明泰科技股份有限公司、隆達電子股份有限公司、明基材料股份有限公司、環球晶圓股份有限公司、新唐科技股份有限公司、中強光電股份有限公司、義隆電子股份有限公司、智原科技股份有限公司、盛群半導體股份有限公司、三晃股份有限公司、聯嘉光電股份有限公司、葡萄王生技股份有限公司、創意電子股份有限公司、五鼎生物技術股份有限公司、京鼎精密科技股份有限公司、宜鼎國際股份有限公司、太平洋醫材股份有限公司、鴻海精密工業股份有限

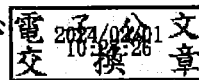
公司、全友電腦股份有限公司、東訊股份有限公司、科儀科技股份有限公司、太欣半導體股份有限公司、普生股份有限公司、台灣茂矽電子股份有限公司、聯合光纖通信股份有限公司、羅技電子股份有限公司、元隆電子股份有限公司、光群雷射科技股份有限公司、智邦科技股份有限公司、立衛科技股份有限公司、台灣光罩股份有限公司、聯亞科技股份有限公司、飛虹高科股份有限公司、盟立自動化股份有限公司、鴻友科技股份有限公司、偉詮電子股份有限公司、漢威光電股份有限公司、鈺創科技股份有限公司、喬鼎資訊股份有限公司、虹光精密工業股份有限公司、星通資訊股份有限公司、星友科技股份有限公司、眾智光電科技股份有限公司、華騰科技股份有限公司、沛亨半導體股份有限公司、榮群電訊股份有限公司、捷耀光通訊股份有限公司、信東生技股份有限公司、冠德光電科技股份有限公司、凱鈺科技股份有限公司、耐能電池股份有限公司、智捷科技股份有限公司、亞信電子股份有限公司、上詮光纖通信股份有限公司、聯穎國際股份有限公司、科林研發股份有限公司、合邦電子股份有限公司、聯陽半導體股份有限公司、致新科技股份有限公司、東盈光電科技股份有限公司、茂德科技股份有限公司、聿勤科技股份有限公司、同亨科技股份有限公司、昇陽國際半導體股份有限公司、聯笙電子股份有限公司、華晶科技股份有限公司、德泰科技股份有限公司、全磊微機電股份有限公司、點晶科技股份有限公司、研能科技股份有限公司、興能高科技股份有限公司、茂達電子股份有限公司、利翔航太電子股份有限公司、光環科技股份有限公司、聚鼎科技股份有限公司、常憶科技股份有限公司、嘉晶電子股份有限公司、舜遠科技股份有限公司、虹冠電子工業股份有限公司、全景軟體股份有限公司、波若威科技股份有限公司、建漢科技股份有限公司、智通聯網科技股份有限公司、優網通國際資訊股份有限公司、牧德科技股份有限公司、金麗科技股份有限公司、昇頻股份有限公司、迅杰科技股份有限公司、聿新生物科技股份有限公司、亞舍立科技股份有限公司、龍彩科技股份有限公司、全智科技股份有限公司、凌威航太科技股份有限公司、前源科技股份有限公司、亞太優勢微系統股份有限公司、核心智識股份有限公司、敏盛科技股份有限公司、達發科技股份有限公司、智成電子股份有限公司、熱映光電股份有限公司、智微科技股份有限公司、益芯科技股份有限公司、世紀創新股份有限公司、洹藝科技股份有限公司、寶碩財務科技股份有限公司、安霸股份有限公司、穎想科技股份有限公司、優貝克科技股份有限公司、科學城物流股份有限公司、龍泰事業股份有限公司、光耀科技股份有限公司、正歲精密工業股份有限公司、采鈺科技股份有限公司、晶心科技股份有限公司、晶錡科技股份有限公司、旺玖科技股份有限公司、機光科技股份有限公司、天擎積體電路股份有限公司、全宏科技股份有限公司、晶相光電股份有限公司、玖鼎電力資訊股份有限公司、瑞鼎科技股份有限公司、均豪精密工業股份有限公司、興訊科技股份有限公司、凌通科技股份有限公司、東京威力科創股份有限公司、鴻璟科技股份有限公司、鼎信光電科技股份有限公司、鈺太科技股份有限公司、泰沂科技股份有限公司、易威生醫科技股份有限公司、應美盛股份有限公司、飛利浦建興數位科技股份有限公司、鑫豪科技股份有限公司、樂福太陽能股份有限公司、來揚科技股份有限公司、祐邦科技股份有限公司、台灣應用光源股份有限公司、宏齊科技股份有限公司、中穎電子股份有限公司、聚晶科技股份有限公司、大中積體電路股份有限公司、寰波科技股份有限公司、宜特科技股份有限公司、福永生物科技股份有限公司、高輝光電科技股份有限公司、優你康光學股份有限公司、芯鼎科技股份有限公司、開元通訊股份有限公司、亦思科技股份有限公司、新代科技股份有限公司、盟創科技股份有限公司、安研科技股份有限公司、晉弘科技股份有限公司、謙華科技股份有限公司、誠加科技股份有限公司、晶測電子股份有限公司、神雲科技股份有限公司、中華精測科技股份有限公司、歐特明電子股份有限公司、普瑞博生技

股份有限公司、萊弗斯基因股份有限公司、仲琦科技股份有限公司、合盈光電科技股份有限公司、台灣彩光科技股份有限公司、休斯微技術股份有限公司、神達數位股份有限公司、普研生技股份有限公司、久昌科技股份有限公司、漢磊科技股份有限公司、五強軟體科技有限公司、鼎元光電科技股份有限公司、正能量智能股份有限公司、兆勁科技股份有限公司、台欣生物科技研發股份有限公司、百泰生物科技股份有限公司、永昕生物醫藥股份有限公司、亞太燃料電池科技股份有限公司、台灣豪雅光學股份有限公司、松瑞製藥股份有限公司、冠橙科技股份有限公司、羅門哈斯亞太研磨材料股份有限公司、旭明光電股份有限公司、達輝光電股份有限公司、泓發樂活氏水科技服務股份有限公司、智晶光電股份有限公司、兆遠科技股份有限公司、浩泰精準股份有限公司、鈺邦科技股份有限公司、聯鈞光電股份有限公司、中國砂輪企業股份有限公司、友輝光電股份有限公司、群豐科技股份有限公司、印能科技股份有限公司、華聯生物科技股份有限公司、錫安生技股份有限公司、國璽幹細胞應用技術股份有限公司、應用奈米醫材科技股份有限公司、萊鎂醫療器材股份有限公司、科進製藥科技股份有限公司、禾伸堂生技股份有限公司、高端疫苗生物製劑股份有限公司、頻率科技股份有限公司、福祿遠東股份有限公司、巨擘科技股份有限公司、新長豐實業股份有限公司、永進生物科技股份有限公司、益華電腦科技股份有限公司、新高生物科學股份有限公司、台灣高技股份有限公司、台灣三偉達醫療器材股份有限公司、上尚科技股份有限公司、全通科技股份有限公司、台灣力森諾科科技股份有限公司、微相科技股份有限公司、智群科技股份有限公司、乾坤科技股份有限公司、中美萬泰科技股份有限公司、台灣應用材料股份有限公司、邁萃斯精密股份有限公司、基鼎科技股份有限公司、信越光電股份有限公司、矽格聯測股份有限公司、台灣信越半導體股份有限公司、樂華科技股份有限公司、台灣宇太新科技股份有限公司、大紘科技股份有限公司、微驅科技股份有限公司、索爾思光電股份有限公司、創介科技股份有限公司、遠東金士頓科技股份有限公司、寧太通訊股份有限公司、台灣美日先進光罩股份有限公司、長茂科技股份有限公司、和康電訊股份有限公司、瀚霖科技股份有限公司、雷松科技股份有限公司、視傳科技股份有限公司、台灣優燈股份有限公司、悅達科技股份有限公司、高平磊晶科系股份有限公司、歐西普亞洲股份有限公司、新茂國際科技股份有限公司、台灣超捷國際股份有限公司、翊傑科技股份有限公司、敦茂科技股份有限公司、威盛電子股份有限公司、鼎威研發股份有限公司、晶發半導體股份有限公司、豪晶科技股份有限公司、智瀚科技股份有限公司、智勤科技股份有限公司、伊諾瓦科技股份有限公司、久元電子股份有限公司、飛鳥車用電子股份有限公司、台灣杜邦股份有限公司、捷通科技股份有限公司、義晶科技股份有限公司、恩霖科技股份有限公司、勇領科技股份有限公司、旺天電子股份有限公司、綠達節能科技股份有限公司、上盈通訊股份有限公司、聚晶半導體股份有限公司、崧銓科技股份有限公司、晶翔機電股份有限公司、漢民科技股份有限公司、勝捷光電股份有限公司、旺北科技股份有限公司、濤鴻科技股份有限公司、鈺登科技股份有限公司、綠品生物科技股份有限公司、云長科技股份有限公司、創量科技股份有限公司、尚青儲存系統股份有限公司、復盛精密工業股份有限公司、台灣威科儀器股份有限公司、威達高科股份有限公司、義碩智能股份有限公司、新加坡商英特格技術研發股份有限公司、行家光電股份有限公司、聯穎光電股份有限公司、源傑科技股份有限公司、視霸光學股份有限公司、奕微科半導體科技股份有限公司、富閣科技股份有限公司、安謀國際科技股份有限公司、宸沅國際股份有限公司、竑新股份有限公司、漢芝電子股份有限公司、軒豐股份有限公司、台灣新思科技股份有限公司、欣盛光電股份有限公司、居禮股份有限公司、安強股份有限公司、衡宇科技股份有限公司、亞東工業氣體股份有限公司、耕源科技股份有限公司、鴻林堂



生物科技股份有限公司、香港商立德國際商品試驗有限公司、育陞半導體股份有限公司、全歲生技股份有限公司、鈺科光電材料股份有限公司、義明科技股份有限公司、天光材料科技股份有限公司、高登智慧科技股份有限公司、永勁電力股份有限公司、景相科技股份有限公司、倍利科技股份有限公司、虹晶科技股份有限公司、微新精密股份有限公司、台聯科股份有限公司、奧樂科技股份有限公司、群曜醫電股份有限公司、翌勤通訊股份有限公司、酷豆股份有限公司、榮晶生物科技股份有限公司、京碼股份有限公司、金佶科技股份有限公司、台灣艾特維股份有限公司、晶祈生技股份有限公司、興富能源科技股份有限公司、科締納科技股份有限公司、兆益奈米科技股份有限公司、鴻驊科技股份有限公司、密科博股份有限公司、怡定興科技股份有限公司、捷能材料股份有限公司、台灣電鏡儀器股份有限公司、華證科技股份有限公司、創宇航太科技股份有限公司、衡陞科技股份有限公司、昇陽電池股份有限公司、兆晟奈米科技股份有限公司、純萃材料股份有限公司、弘泰電力股份有限公司、天亮醫療器材股份有限公司、晶智達光電股份有限公司、譜鉅科技股份有限公司、晶成半導體股份有限公司、騰鏢鐳射股份有限公司、安肽生醫科技股份有限公司、中光電智能機器人股份有限公司、美商英諾帆有限公司、樂鑫材料科技股份有限公司、辰隆科技股份有限公司、高通半導體有限公司、盟英科技股份有限公司、智準生醫科技股份有限公司、建興儲存科技股份有限公司、瑞愛生醫股份有限公司、普利恩股份有限公司、中光電智能雲服股份有限公司、來達科技股份有限公司、高昌生醫股份有限公司、博鑫醫電股份有限公司、啟動生物科技股份有限公司、創新服務股份有限公司、智捷能源股份有限公司、聿健生物科技股份有限公司、宜錦科技股份有限公司、創鑫智慧股份有限公司、達擎股份有限公司、奈特視訊科技股份有限公司、精映科技股份有限公司、易達通科技股份有限公司、昱嘉科技股份有限公司、鎔聯通科技股份有限公司、群翌能源股份有限公司、金兆鎔科技股份有限公司、誠治生醫股份有限公司、豐康微流體晶片股份有限公司、威力富科技股份有限公司、盧森堡商達爾國際股份有限公司新竹分公司、芯量科技股份有限公司、希映顯示科技股份有限公司、新加坡商惠普全球科技股份有限公司、鴻揚半導體股份有限公司、和耀生技股份有限公司、元瀚材料股份有限公司、漢特科技股份有限公司、奈盾科技股份有限公司、竹寶智能科技股份有限公司、元豐新科技股份有限公司、星亞視覺股份有限公司、瑞曜科技股份有限公司、以色列商前銳科技股份有限公司、積亞半導體股份有限公司、昱鉉科技股份有限公司、睿控網安股份有限公司、五強軟體科技股份有限公司、長典生物科技股份有限公司、黑澤科技股份有限公司、夏目智能股份有限公司、米雷迪恩飛秒光源股份有限公司、中光電智能物流股份有限公司、睿智科技股份有限公司、晉昇智能感測股份有限公司、峻魁智慧股份有限公司、卡爾蔡司股份有限公司、科準科技股份有限公司、益邦製藥股份有限公司、膠原科技股份有限公司、台灣半導體照明股份有限公司、吉佳科技股份有限公司、鎧暘科技股份有限公司、友晁能源材料股份有限公司、台灣奈米碳素股份有限公司、碩晨生醫股份有限公司、英特盛科技股份有限公司、旭能醫藥生技股份有限公司、鼎謙科技股份有限公司、霖揚生技製藥股份有限公司、晶化科技股份有限公司、卓越光纖股份有限公司、承鼎精密股份有限公司、誠屏科技股份有限公司、宇康醫電股份有限公司、鏘創顯示科技股份有限公司、先發電光股份有限公司、恩馳科技有限公司、勝利仕科技股份有限公司、喬信電池股份有限公司、樸實美股份有限公司、中光電智能感測股份有限公司、和光光電股份有限公司、艾格生科技股份有限公司、凱諾科技股份有限公司、新加坡商群豐駿科技股份有限公司、旭積科技股份有限公司、保瑞聯邦股份有限公司、兆通光電股份有限公司

副本：財團法人台灣建築中心、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心



裝

訂

線



# 【推動「科學園區淨零建築發展」說明會】

## 活動摘要

內政部建築研究所依據淨零建築推動策略，建立建築能效分級評估制度，將建築能效依節能成效分為 7 個等級，其中最高等級為近零碳建築(第 1+級)，可達約 50% 的節能，並自 111 年 1 月 1 日實施。為達成前揭 2050 淨零建築目標，「我國推動淨零建築與應用推廣計畫」分年分階段辦理淨零建築與建築能效評估制度推廣說明會，擴大各界公私協力共同推動淨零建築之發展。

本次說明會由財團法人台灣建築中心主辦，將針對內政部淨零建築發展政策，以科學園區企業 ESG 深遠發展，基於自身興辦廠房或辦公建築開發之法令範疇、既有辦公建築之能效評估 BERS 盤查提供說明與諮詢，邀請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提供綠色債券籌措內容及方式說明，及本中心提供建築能效申請認定範疇及審查資料並能接軌綠色融資實施說明，俾利產業協力輔導企業資產用戶，鼓勵企業在積極投入永續時，由興辦設計至營運皆納入建築能效評估，進一步擴大企業永續報告書的量化揭露，思考如何透過綠色財務工程履行 ESG 的承諾。

## 活動資訊

本次說明會為免費報名，實體場次名額為 100 人。報名截止時間 為 2 月 26 日或額滿為止。

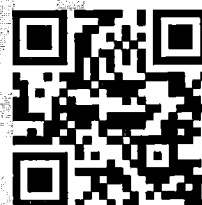
- 日期：113 年 2 月 27 日（二）下午 13:30 - 16:30
- 地點：台灣科學園區科學工業同業公會(會本部暨新竹區處)203 會議室
- 地址：新竹科學園區展業一路 2 號
- 指導單位：內政部建築研究所
- 主辦單位：財團法人台灣建築中心
- 協辦單位：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
- 聯繫窗口：02-86676111 轉 210 楊先生/轉 159 張先生
- 報名網址：<https://reurl.cc/WRGgLD>

活動議程

| 時間          | 時長<br>(分鐘) | 講題                                       | 講者                           |
|-------------|------------|--|------------------------------|
| 13:00-13:30 | 30         | 報到入場                                     |                              |
| 13:30-13:40 | 10         | 貴賓致詞                                     |                              |
| 13:40-14:10 | 30         | 綠建築發展與淨零建築轉型策略                           | 內政部建築研究所<br>環境控制組 羅時麒組長(邀請中) |
| 14:10-14:40 | 30         | 企業建設基於永續經濟活動指引之綠色債券籌措內容及興辦方式說明           | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 債券部 黃仁宏副理   |
| 14:40-15:00 | 20         | 交流休息                                     |                              |
| 15:00-15:40 | 40         | 新建 BERSn /既有 BERSe 之建築能效申請認定範疇、審查資料及案例說明 | 財團法人台灣建築中心<br>王婉芝副執行長        |
| 15:40-16:10 | 30         | 解析淨零建築接軌綠色融資實施說明                         | 財團法人台灣建築中心<br>林穎立經理          |
| 16:10-16:30 | 20         | 綜合討論                                     |                              |

報名說明

- 報名網址：<https://reurl.cc/WRGgLD>
- 報名方式：請掃描右方 QR CODE 或至上述網址報名。



聯絡資訊

- 02-86676111 轉 210 楊先生/轉 159 張先生
  - 建築能效 BERS 諮詢 官方 LINE 帳號 (ID:@440qzmng)
- 📞如有問題請來電詢問或掃描右方 QR CODE 加入官方 LINE





# 推動科學園區淨零建築發展

淨零建築與建築能效評估制度BERS推廣說明會

BUILDING ENERGY-EFFICIENCY RATING SYSTEM

## 活動議程

13:00 - 13:30

報到入場

13:30 - 13:40

貴賓致詞

13:40 - 14:10

綠建築發展與淨零建築轉型策略

14:10 - 14:40

企業建設基於永續經濟活動指引之  
綠色債券籌措內容及興辦方式說明

15:00 - 15:40

新建BERSn / 既有BERSe之建築能效  
申請認定範疇、審查資料及案例說明

15:40 - 16:10

解析淨零建築接軌綠色融資實施說明

16:10 - 16:30

綜合討論

自有資產永續轉型的國家評鑑

接軌綠色金融的財務規劃

與國際資金對話的新契機

落實企業邁向ESG目標

2024  
02 / 27  
13:30 - 16:30

台灣科學園區科學工業同業公會203會議室  
- 新竹科學園區展業一路2號 -

【BERS輔導諮詢】

【報名連結】

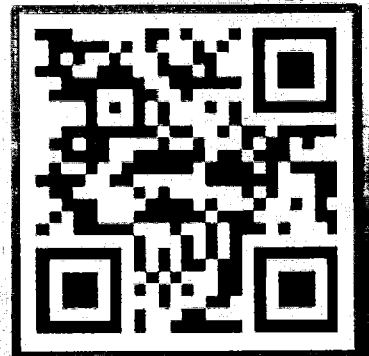
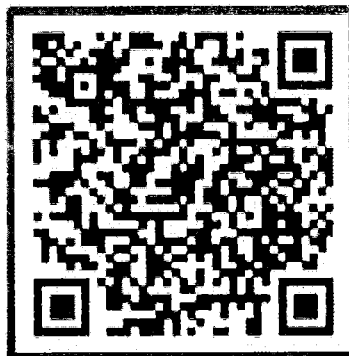
指導單位 | 內政部建築研究所

主辦單位 | 財團法人台灣建築中心

協辦單位 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

電話 | (02)8667-6111 #210楊先生

電子郵件 | [woo157632@tabc.org.tw](mailto:woo157632@tabc.org.tw)



主辦單位保留變更、活動解釋及取消本活動之權利，若有相關異動將會公告於網站。